

Halbleiterbauelemente
Mechanische und klimatische Prüfverfahren
Teil 3: Äußere Sichtprüfung
(IEC 60749-3:2002) Deutsche Fassung EN 60749-3:2002

DIN
EN 60749-3

ICS 31.080.01

Teilweiser Ersatz für
DIN EN 60749:2002-09
Siehe Beginn der Gültigkeit

Semiconductor devices
Mechanical and climatic test methods
Part 3: External visual inspection
(IEC 60749-3:2002);
German version EN 60749-3:2002

Dispositifs à semiconducteurs
Méthodes d'essais mécaniques et climatiques
Partie 3: Examen visuel externe
(CEI 60749-3:2002);
Version allemande EN 60749-3:2002

Die Europäische Norm EN 60749-3:2002 hat den Status einer Deutschen Norm.

Beginn der Gültigkeit

Die EN 60749-3 wurde am 2002-07-02 angenommen.

Daneben dürfen die Festlegungen von Kapitel 1, Abschnitt 5 der DIN EN 60749:2002-09 noch bis 2005-07-01 angewendet werden.

Nationales Vorwort

Für die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium K 631 „Halbleiterbauelemente“ der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE zuständig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom TC 47 „Semiconductor devices“ erarbeitet. Sie geht auf einen Beschluss des TC 47 zurück, die in IEC 60749 enthaltenen Prüfverfahren in getrennten Teilen zu veröffentlichen.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zum Jahr 2012 unverändert bleiben soll. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation

- bestätigt,
- zurückgezogen,
- durch eine Folgeausgabe ersetzt oder
- geändert.

Änderungen

Gegenüber DIN EN 60749:2002-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- vollständige Neufassung der in DIN EN 60749, Kapitel 1, Abschnitt 5, enthaltenen Prüfung.

Frühere Ausgaben

DIN 41794-1: 1972-06

DIN IEC 60749: 1987-09

DIN EN 60749: 2000-02, 2001-09, 2002-09

Fortsetzung 4 Seiten EN

DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE

– Leerseite –